


+1 Nächste Buchung sichert die Durchführung! ⓘ

AVT – Aufbau- und Verbindungstechnik

Zuverlässiger Aufbau elektronischer Schaltungen

Beginn: 23.11.2026 - 09:00 Uhr	 Flex: Ostfildern oder Online	Veranstaltungsnr.: 35408.00.009	Präsenz oder Online
Ende: 24.11.2026 - 17:00 Uhr		Leitung	EUR 1.250,00 (MwSt.-frei)
Dauer: 2,0 Tage		<u>Dr.-Ing. Roland Friedrich</u> ehem. Hochschule Esslingen	Mitgliederpreis ⓘ EUR 1.125,00 (MwSt.-frei)

in Zusammenarbeit mit:



BESCHREIBUNG

Die Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) stellt die Grundlage für die Funktion einer elektronischen Schaltung dar. Ohne eine angepasste, für den jeweiligen Zweck geeignete AVT kann beispielsweise ein Kfz-Steuergerät seine Funktion nicht zuverlässig über viele Jahre hinweg bei häufigen Temperatur- und Lastwechseln erfüllen oder in der Nähe von heißen Motorteilen funktionieren.

Dieses Seminar stellt die grundlegenden Prozesse und Technologien in der Aufbau- und Verbindungstechnik dar. Es erläutert die jeweiligen Einsatzgebiete für Leiterplatten und Keramiktechnologien wie Dickschicht- und Dünnschichtbaugruppen. Darüber hinaus behandelt das Seminar die für den Aufbau benötigten Prozesse wie Beschichten, Löten, Bonden und Kleben von Bauteilen bzw. Dice (Chips) in Gehäusen oder auf Schaltungsträgern. Dazu gehören nicht nur bewährte, sondern auch neuere, in der Entwicklung befindliche Techniken wie KlettWelding/NanoWiring.

Ziel der Weiterbildung

Das Seminar vermittelt die Grundlagen der AVT und geht dabei auch auf modernste Technologien ein. Das Seminar soll Sie in die Lage versetzen, aus einer Vielzahl von Technologien die richtige für Ihre Applikation im Hinblick auf Kosten, Zuverlässigkeit und Funktionalität auszuwählen und einzusetzen.

IMMER TOP!

Unser Qualitätsversprechen



Seit über 65 Jahren gehört die Technische Akademie Esslingen (TAE) mit Sitz in Ostfildern – nahe der Landeshauptstadt Stuttgart – zu Deutschlands größten Weiterbildungs-Anbietern für berufliche und berufsvorbereitende Qualifizierung im technischen Umfeld. Unser Ziel ist Ihr Erfolg. Egal ob Seminar, Zertifikatslehrgang oder Fachtagung, unsere Veranstaltungen sind stets abgestimmt auf die Bedürfnisse von Ingenieuren sowie Fach- und Führungskräften aus technisch geprägten Unternehmen. Dabei können Sie sich stets zu 100 Prozent auf die Qualität unserer Angebote verlassen. Warum das so ist?

PROGRAMM

Montag, 23. und Dienstag, 24. November 2026
9:00 bis 12:15 und 13:45 bis 17:00 Uhr

Leiterplatten

- Eigenschaften der Basismaterialien
- Herstellungsprozesse für Leiterplatten
- Aufbau von Leiterplatten bei Mehrlagenverdrahtung
- Feinstleiter-Technik (HDI-Leiterplatten)

Keramiktechnologien

- Dickschichttechnik
- Dünnschichttechnik
- Low and High Temperature Cofired Ceramics (LTCC und HTCC)

AVT der Halbleiter

- Aufbau von integrierten Schaltungen
- Möglichkeiten zur Die-Montage
- Gehäusebauformen von Halbleitern und Schichtschaltungen

Verbindungstechnologien

- Lötten
- Kleben
- Bonden
- Flip-Chip-Technologie

Neuere AVT-Prozesse

- KlettWelding/NanoWiring
- Press-Fit-Technologie
- Hot Embossing

TEILNEHMER:INNENKREIS

Das Seminar richtet sich an Ingenieure, Techniker und Entscheider, die moderne AVT anwenden wollen. Schwerpunkt ist die praxisgerechte Umsetzung neuer AV-Technologien.

REFERENT:INNEN



Dr.-Ing. Roland Friedrich

ehem. Hochschule Esslingen

ehem. Hochschule Esslingen, Standort Göppingen

Weitere Veranstaltungen

[LTSPICE für Fortgeschrittene](#)

[Basiswissen Elektronik](#)

[Aufbauseminar Elektronik](#)

[Einführung in die Analogsimulation mit LTSPICE](#)

VERANSTALTUNGSORT UND HOTEL

Technische Akademie Esslingen

An der Akademie 5
73760 Ostfildern



[Anfahrt](#)

Die TAE befindet sich im Südwesten Deutschlands im Bundesland Baden-Württemberg – in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Stuttgart. Unser Schulungszentrum verfügt über eine hervorragende Anbindung und ist mit allen Verkehrsmitteln gut und schnell zu erreichen.

Hotelübernachtung benötigt?

Über den nachfolgenden Link finden Sie nahegelegene Hotels in direkter Umgebung zu TAE-Konditionen:

GEBÜHREN UND FÖRDERMÖGLICHKEITEN

Die Teilnahme beinhaltet [Verpflegung](#) (vor Ort) sowie ausführliche Unterlagen.

Preis:

Die Teilnahmegebühr beträgt:

1.250,00 € (MwSt.-frei) vor Ort

1.250,00 € (MwSt.-frei) pro Teilnehmer live online

Fördermöglichkeiten:

Für den aktuellen Veranstaltungstermin steht Ihnen die [ESF-Fachkursförderung](#) leider nicht zur Verfügung.

Für alle weiteren Termine erkundigen Sie sich bitte vorab bei unserer [Anmeldung](#).

Andere Bundesland-spezifische Fördermöglichkeiten finden Sie [hier](#).

Inhouse Durchführung:

Sie möchten diese Veranstaltung firmenintern bei Ihnen vor Ort durchführen? Dann fragen Sie jetzt ein individuelles [Inhouse-Training](#) an.